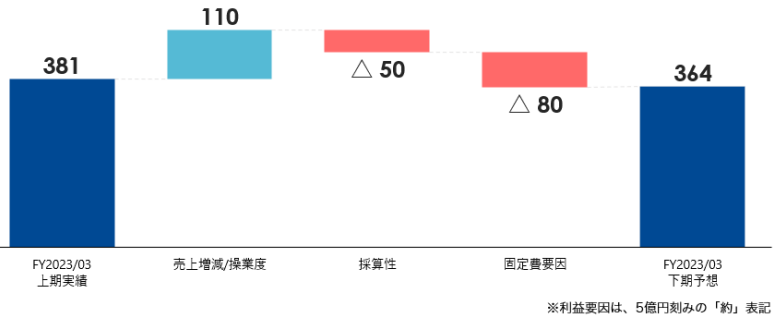
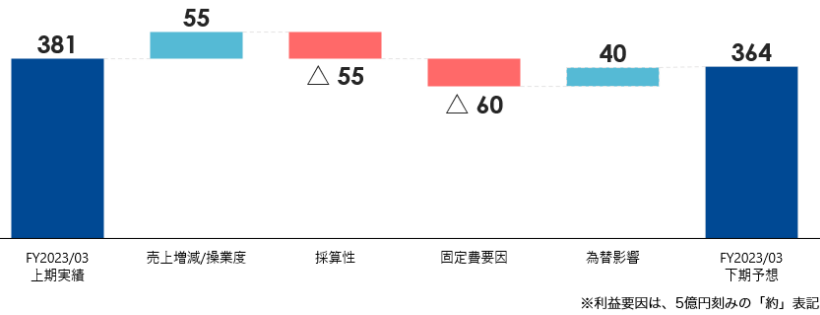


FY2023 2Q (2023年3月期 第2四半期) 決算説明会 Q&A

- 第1回：2022年10月31日 (Q1~Q16)
- 第2回：2022年11月25日 (Q17~Q18)

第1回 2022年10月31日 (Q1~Q16)		
Q1	SPE	地域別売上比率について、2Q で中国売上比率が減った理由、また 4Q で増える予想をしている理由を教えてください。また米中の輸出規制の影響を定量的に教えてください。
A1		<ul style="list-style-type: none"> ・地域別売上比率の変動については、お客様の要求納期に従って出荷し、搬入立ち上げ基準で売上計上しており、たまたま実際の搬入タイミングがそうなったとご理解いただきたい。 ・米中貿易摩擦の影響については、今期の通期売上予定の中には規制対象となる装置群があまり含まれておらず、通期予想を据え置いた。来期についてはコメントするのはまだ早いと考えており、関係各所、政府機関と相談しながら精査、検討中。米国は強い輸出規制を出したが、日本製品については米国製技術を一定量含んでいなければ規制の範囲には入らない。今後の動きを注視しながら来期の計画を精査していきたい。
Q2	SPE	IR デイで説明のあった来年の WFE 予想と、来期の SCREEN の売上計画の達成について見方は変化無いか？
A2		10月13日に新しい米中輸出規制が明らかになり、状況は不透明になってきた。先ほど説明したように、今後の影響を精査している過程であり、その精査が終わるまでは来年の WFE および来期売上計画への影響は読みづらい。
Q3	SPE	来年の WFE 予想を示すことは（今はまだ）難しいとの事だが、御社の来年度売上予想の方向感は何？
A3		2Q の受注は 1Q 同等の実績だったことに加え、3Q、4Q の受注は、新工場稼働の効果によりむしろ増えてくると考えている。中期経営計画の売上目標（来期）は達成できるとの考えは変えていない。
Q4	SPE	通期のアプリケーション別売上予想グラフ（説明資料）を見ると、前回（7月予想）に比べるとファウンドリーが増えて、NAND 構成比が減少している。これは、中国への輸出規制の影響も入っているのか？それとも NAND 顧客の投資が弱含んでいるのか？
A4		米国の対中輸出規制の影響ではない。NAND の比率が下がっているのは実際の投資減速度合が反映されているため。売上比率予想は 5%刻みの表示で分かりづらいかもかもしれないが、実際の数字も同じ傾向。
Q5	SPE	2Q でポストセールスの通期売上予想を若干上方修正しているがその背景は何？その分、新規装置の売上が減少していると思われるが、プッシュアウトまたはキャンセルなどが発生しているのか？

A5		メモリ顧客の投資で、皆さんご存じのとおりプッシュアウトがある。お客さまの工場も稼働率に少し余裕が出てきており、改造の提案を受け入れて頂けるようになってきた結果と考える。改造は本体より収益率が良いため、営業利益率の向上を期待しているが、一方で原材料コストアップの影響があり通期の利益計画は据え置いた。
Q6	SPE	1Q から 2Q で売上は伸びたが、営業利益率が若干低下した背景は？また下期以降の営業利益率の見通しは？
A6		営業利益率は 1Q と 2Q でさほど差はなく、差は単純にプロダクトミックスによるものである。下期については、原材料コストアップの影響や上期で使いきれなかった固定費（開発費）を下期で使っていくため、営業利益率は多少落ちるだろう。
Q7	SPE	営業利益の増減について、特に固定費について上期、下期の比較でどう見ているか？
A7		<p>下期の固定費増加は 80 億円程度を見込んでいる。原材料コストアップについては、為替の追い風を打ち消してしまうぐらいの影響があると理解頂きたい。</p> <p>■補足説明：</p> <p>●営業利益増減分析>> FY2023/03 上期実績 vs 下期予想</p>  <p>以下ご参照：為替影響を加味したもの。</p> <p>●営業利益増減分析>> FY2023/03 上期実績 vs 下期予想（為替影響含む）</p>  <p>>>売上増減/操業度のプラス要因：SPE がほとんど（GA はマイナス影響） >>採算性のマイナス要因：ほとんどが SPE（原材料コストアップ） >>固定費のマイナス要因：ほとんどが SPE（成長投資） >>為替：SPE、GA、PE に影響</p>
Q8	SPE	アプリケーション別の売上で、「ファウンドリー」の中身は？また「パワーデバイス」について何かトレンドはあるか（シリコンと SiC を比較して、など）？

A8		<ul style="list-style-type: none"> ・ファウンドリーセグメントには、ファウンドリービジネスをされているお客様が全て入っている。売上は台湾のお客様が牽引しているが、タイミングによっては中国、米国のファウンドリー比率も上がる時がある。 ・パワーデバイスの売上は、SiC 向けも徐々に増えてきてはいるが、シリコンパワーデバイスには 300 mm化の流れもあり、まだシリコン向けの売上が主体である。
Q9	SPE	ファウンドリー顧客の要求のトレンドを教えてください。
A9		「先端デバイスを作るシステムを持ってきて欲しい」「プロセス開発も一緒にやって欲しい」という要望が多い。納期的な要求も厳しい。
Q10	SPE	スライド（説明資料）p.13 のファウンドリーの説明の「各技術ノードで投資優先順位調整」の意味は？
A10		お客様の中で「このラインに先に持ってきて欲しい」「ここは待てる」というように優先順位を見直されているという意味であって、技術ノードに優先順位があって調整しているという意味では必ずしもない。
Q11	SPE	中国マーケットで、規制強化を見据えた駆け込み需要などあるか？
A11		そのモチベーションは出ている。ただ、弊社だけでなく業界全体がお客様からの需要に供給が追いついていないので、お客様と納期の調整をしながら個別に対応せざるを得ない状況と思われる。2Q の受注には、そうした駆け込み需要は無い。
Q12	SPE	中国への米国の輸出規制について、日本政府、経済産業省との話はどうなっているか？
A12		経済産業省とのやりとりについてはコメントを差し控えたい。一定量の米国製技術を使っていなければ、規制に該当しないことは、日本の装置メーカーも認識している。
Q13	SPE	現在の受注残は、今後の売上をどれくらいカバーできるレベルか？また今期の中国向け売上の中の輸出規制対象分はどれくらいか？
A13		受注残については下期の売上を全てカバーできるレベルである。我々は納期確定したものだけを受注処理する方式を取っているため、それほど先ものは存在していない。今期の輸出規制の対象となる装置（仮に日本製品も対象となった場合）の売上比率はさほど多くない（数十億円レベル）。
Q14	SPE	来期費用増の計画（50 億円程度）に変化は無いか？
A14		我々としては計画通りの費用増加を見込んでいるが、設備投資、研究開発費、人員増など、全て認めるかは今後の状況次第である。
Q15	SPE	メモリー向け売上にはプッシュアウトがあり、その分は他の案件で補填していると説明されたが、（この投資減速の状況下で）どのような引き合いで補填出来るのか？また、3、4Q の受注が増えてゆく予想との事だが？
A15		PO（注文書）を既に頂いているものの、納期が確定していない引き合い（受注計上前の案件）があり、それらで補填が可能である。3Q、4Q も個別に商談の詳細が見えており、好調な受注は続くと考えている。
Q16	GA/PE	GA についてはヨーロッパの景気後退、PE は半導体投資の調整などの懸念があると思うが、今後をどう見ているか？

A16		<ul style="list-style-type: none"> ・GA については、ヨーロッパで紙不足の懸念がある。需要はあるが印刷が出来ない状況。一方米国では DX、GX の流れから POD 化が進んでおり、欧州の売上を補っている。 ・PE については、スマホ・PC 需要が少し弱含む一方で、データセンター向け需要は旺盛である。但し、お客さまの顔ぶれに変化が見られるほか、納期要請の圧力（早期納入への圧力）が若干弱くなってきている。3Q の受注は相応に見えているが、4Q にかけて予想精度を上げていく。
第 2 回 2022 年 11 月 25 日 (Q17~Q18)		
Q17	FT	足元の状況は？
A17		今期は既に業績予想を下方修正。受注は回復しつつあるも、足元の受注残高に鑑み、来期の売上高は今期より厳しくなる想定。赤字幅を低減すべく再生策を検討中。
Q18	FT	今後の見通しは？
A18		ディスプレイ関連や印刷 OLED を中心に事業再生を進めるも、エネルギー（水素関連）をテーマにした新規事業には開発投資を継続、中長期的な成長を期待している。

HD: ホールディングス、SPE: 半導体製造装置事業、GA: グラフィックアーツ機器事業、
FT: ディ스플레이製造装置および成膜装置事業、PE: プリント基板関連機器事業